

LEAD FRAME FORM FOR IC CARD MODULE

Patent Number: JP6092076
Publication date: 1994-04-05
Inventor(s): INOUE AKINOBU; others: 02
Assignee: OKI ELECTRIC IND CO LTD

Applicant(s):
Requested Patent: JP6002076
Number: JP10020246547 19920916

Application Number: JP1652026547 16520265

Priority Number(s):

IPC Classification: B42D15/10 . G06K19/077 ; H01L23/00 ; P01E23/30

IPC Classification

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To improve the adhesion between a lead frame and mold resin for a read/write module used in an IC card so that terminals may not be separated from the mold when the module is bent.
CONSTITUTION: In an island 14 and terminals 15 of a lead frame 13, sectional forms of half etching parts 14a of the island end and half etching parts 15a of the terminal ends are made to be oblique which can be pinched by mold resins 17a and 17b.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願登録番号

特開平6-92076

(43) 公開日 平成6年(1994)4月5日

(51) Int.Cl. ¹ B 42 D 15/10 G C 6 K 19/077 H 01 L 23/00 23/50	識別記号 521	序内整理番号 9111-2C	F I	技術表示箇所
	A 9272-4M 8623-5L	G 06 K 19/00 L		

審査請求 未請求 請求項の数1(全5頁) 最終頁に続く

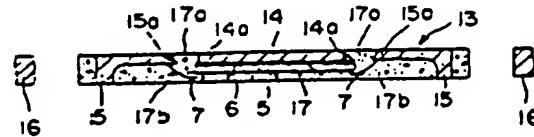
(21) 出願番号 特願平4-246547	(71) 出願人 神電氣工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
(22) 出願日 平成4年(1992)9月16日	(72) 発明者 井上 明信 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電氣 工業株式会社内
	(72) 発明者 小林 治文 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電氣 工業株式会社内
	(72) 発明者 山口 忍士 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電氣 工業株式会社内
	(74) 代理人 方理士 鈴木 敏明

(54) [発明の名称] ICカードモジュール用リードフレーム形状

(57) [要約]

[目的] ICカードに搭載される、読み出し/書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、リードフレームとモールド基板との密着力を向上させて、モジュールの曲げに対する端子部の剥離耐力を向上させるものである。

[構成] リードフレーム13のアイランド14および端子15において、そのアイランド端ハーフエッティング部14aおよび端子端ハーフニッティング部15aの断面形状を、モールド基板17aおよび17bで扶持できる板状形状としたものである。



主張するリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

【特許請求の範囲】

【請求項1】 1Cカードに搭載され、読み出し／書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、

リードフレームのアイランド部および、または端子部のハーフエッティング部の断面形状を、モールド樹脂にて挿持できる傾斜形状にすることを特徴とする1Cカードモジュール用リードフレーム形状。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、1Cカードに搭載される読み出し／書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 図3は、従来のリードフレーム形状を備えた1Cカードモジュールを示す平面図およびそのA-A'断面図である。図において、1はその詳細な構成を図4に示すように、例えば板厚0.6mmのリードフレームである。このリードフレーム1はアイランド2、端子3および外枠4からなっている。5はリードフレーム1のアイランド2の下部に、ボンディングシート6を介してボンディングした半導体素子7、8は端子3と半導体素子5間をワイヤボンディングしたボンディングワイヤ、9はモールド樹脂封止金型にてモールド樹脂境界線10内を充填したモールド樹脂、10はこのモールド樹脂封止金型のエジネクトピンである。

【0003】 次に、上記構成のリードフレームの製造工程を図5(a)～図5(c)を参照して説明したのち、1Cカードモジュールの製造方法を図3(A)および図3(B)を参照して説明する。まず、図5(A)に示すように、リードフレーム1の母材1aの表面に、リード形状として残した部分にレジスト11を散布する。そして、図5(B)に示すように、矢印12の方向からエッチングする。そして、図5(C)に示すように、このレジスト11を除去することにより、図4に示すリードフレーム1を製造することができる。そして、このリードフレーム1のアイランド2の下底に、半導体素子5をボンディングシート6を介してボンディングする。そして、この半導体素子5と端子3間をボンディングワイヤ7によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線5内をモールド樹脂6で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジネクトピン10により金型より突き上げて、取り出したのち、個別化し、図示せぬ1Cカード上に実装するものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記構成のリードフレーム形状では、アイランド2のハーフエッティング部のアイランド本形状2a(図5(C)参照)および端子3のハーフエッティング部の端子3a(図5(C)参照)

(図5(C)参照)がR形状になっているため、リードフレーム1とモールド樹脂6とは接着力からて保持されている。このため、(A)モールド成形時、モールド樹脂封止金型内のエジネクトピンにて突き上げる際、モールド樹脂と金型との隙間時、モールド樹脂とモールド樹脂封止金型との接着力により、モジュールを反らせ、端子部が剥離してしまうこと、(B)モジュールを1Cカード上に実装したのち、折り曲げに際により端子部が剥離し、この剥離により、ワイヤー断線、およびモジュール内へ水分が侵入し、A1腐食などが発生するという問題点があった。

【0005】 本発明は、以上述べた端子部の剥離によるワイヤーの断線およびA1腐食という問題点を除去するため、端子部の断面形状を変えることにより、端子とモールド樹脂との剥離をなくすことができる形状を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明に係る1Cカードモジュール用リードフレーム形状は、そのアイランド端ハーフエッティング部および端子端ハーフエッティング部の断面形状を、モールド樹脂にて挿持できる傾斜形状にするものである。

【0007】

【作用】 本発明は、端子部の剥離耐力を大幅に向上することができる。

【0008】

【実施例】 図1は本発明に係る1Cカードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えた1Cカードモジュールを示す断面図である。図において、12はその製造工程を図2(A)～図2(E)に示すリードフレームである。このリードフレーム12はアイランド14、複数個の端子15および外枠16を備えている。特に、アイランド14のアイランド端ハーフエッティング部14aおよび端子15の端子端ハーフエッティング部15aの断面形状は、モールド樹脂17にて挿持できるよう傾斜させて形成したものである。具体的には、アイランド端ハーフエッティング部14aおよび端子端ハーフエッティング部15aが形成された空間に充填されたモールド樹脂17bによってアイランド14および複数個の端子15の端部を挿持できるように形成される。

【0009】 次に、上記構成のリードフレームの製造工程を図2(A)～図2(E)を参照して説明したのち、1Cカードモジュールの製造方法について説明する。まず、図2(E)に示すように、リードフレーム12の母材13aの両表面に、リード形状として残した部分にレジスト18を付ける。そして、図2(B)に示すように、母材13aの一方の表面をエッチングする。そして、図2(C)に示すように、母材13aのエッチングした部分に、レジスト19を付ける。そして、図2

3
(D)に示すように、母材13を他の表面をエッティングする。そして、図2(E)に示すように、レジスト18および19を除去することにより、リードフレーム18および19を形成することができる。このようにして、アイランド3を製造することができる。モールド樹脂17にて保持できるように傾斜させて形成することができる。そして、このリードフレーム13のアイランド14の下部に、半導体素子5をボンディングシート6を介してボンディングする。そして、この半導体素子5と端子15間をボンディングワイヤ7によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線内をモールド樹脂17で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジェクトピンにより、金型より突き上げて、取り出したのち、倒片化し、図示せぬICカード上に実装するものである。

【0010】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状によれば、アイランド端ハーフエッティング部および端子端ハーフエッティング部の断面形状を、モールド樹脂にて保持できるように形成したので、端子部の耐電荷力が向上し、

ライヤー既録今A1底面の凹凸を防ぐことができ、品質を向上することができるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えたICカードモジュールを示す断面図である。

【図2】図1のICカードモジュール用リードフレーム形状の製造工程を示す断面図である。

【図3】從来のICカードモジュールを示す平面図および断面図である。

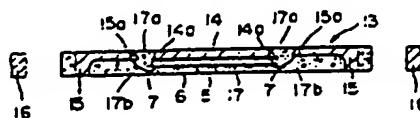
【図4】図3のリードフレームを示す平面図である。

【図5】図3のリードフレームの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

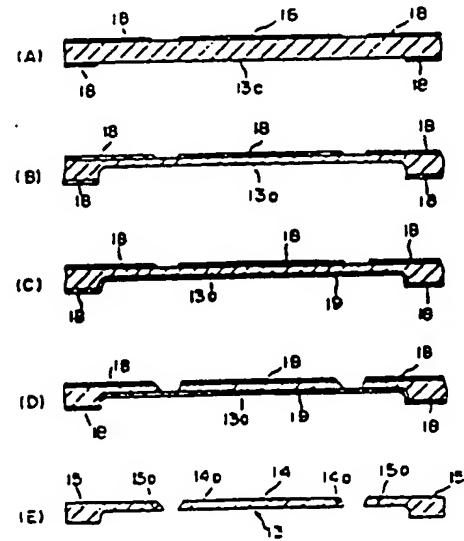
- | | |
|--------|---------|
| 5 | 半導体素子 |
| 13 | リードフレーム |
| 14 | アイランド |
| 15 | 端子 |
| 16 | 外枠 |
| 17 | モールド樹脂 |
| 18, 19 | レジスト |

[図1]



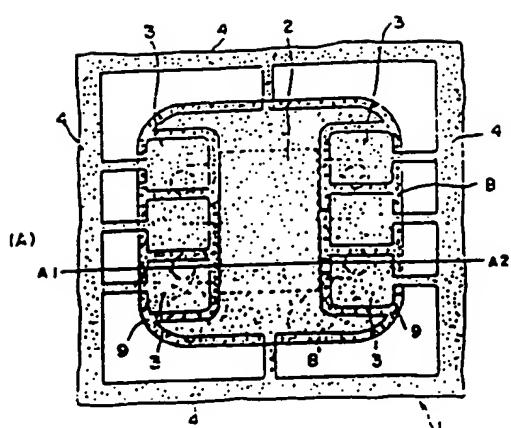
本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

[図2]

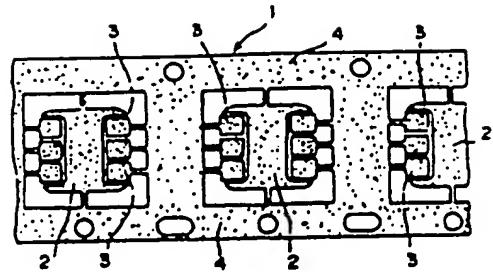


本発明のリードフレームの製造工程を示す断面図

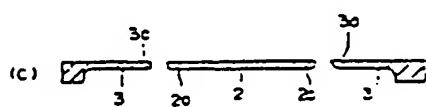
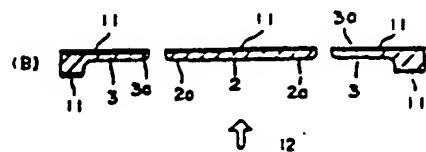
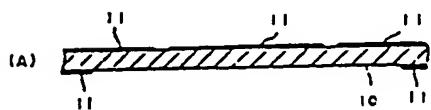
〔図3〕



〔図4〕



〔図5〕



特許平6-92076

(5)

フロントページの焼き

(51) 国内
H01L 23/50

識別記号 序内整理番号 F 1
H 9272-4M

技術表示箇所

(19) 日本国特許庁 (JP)

(2) 公開特許公報 (A)

(1) 特許出願公開番号

特開平6-92076

(43) 公開日 平成6年(1994)4月5日

(51) Int.Cl. ¹	識別記号	序内整理番号	F 1	技術表示箇所
B 42 D 15/10	521	9111-2C		
G 6 K 19/077				
H 01 L 23/00				
23/50	A 5272-6M 8623-5L		G 06 K 19/00 L	審査請求 実質請求 検索項目の数1(全5頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平4-246547

(71) 出願人 000000295

神電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(22) 出願日 平成4年(1992)9月16日

(72) 発明者 井上 義信

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気
工業株式会社内

(72) 発明者 小林 治文

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気
工業株式会社内

(72) 発明者 山口 忠士

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気
工業株式会社内

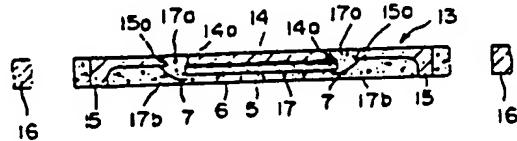
(74) 代理人 加藤 敏明

(54) 【発明の名称】 ICカードモジュール用リードフレーム形状

(57) 【要約】

【目的】 ICカードに搭載される、読み出し/書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、リードフレームとモールド樹脂との密着力を向上させて、モジュールの曲げに対する端子部の剥離耐力を向上させるものである。

【構成】 リードフレーム13のアイランド14および端子15において、そのアイランド端ハーフエッティング部14aおよび端子端ハーフエッティング部15aの断面形状を、モールド樹脂17aおよび17bで扶持できる傾斜形状としたものである。



本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

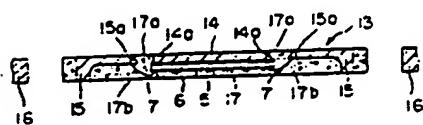
(3)

(D) に示すように、母材 13 との他の位置をエッティングする。そして、図 2 (E) に示すように、レジスト 18 および 19 を除去することにより、リードフレーム 16 および 19 を形成することにより、リードフレーム 16 および 19 を形成することにより、リードフレーム 16 および 19 を形成することができる。このようにして、アイランド 14 と端子部ハーフエッティング部 15 および端子部ハーフエッティング部 15 の断面形状は、モールド樹脂 17 にて保持できるように保持させて形成することができ。そして、このリードフレーム 16 のアイランド 14 の下部に、半導体素子 5 をボンディングシート 6 を介してボンディングする。そして、この半導体素子 5 と端子 15 間をボンディングワイヤ 7 によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線内をモールド樹脂 17 で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のニジエクトピンにより、金型より突き上げて、取り出したのち、極片化し、図示せぬ IC カード上に実装するものである。

【0010】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係る IC カードモジュール用リードフレーム形状によれば、アイランド端子ハーフエッティング部および端子部ハーフエッティング部の断面形状を、モールド樹脂にて保持できるように形成したので、端子部の剥離耐力が向上しきるようになる。

〔図 1〕



半導体リードフレームを有する IC カードモジュールの構造

ライヤー断線やんく腐食の発生を防ぐことができ、品質を向上することができるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

〔図 1〕 本発明に係る IC カードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えた IC カードモジュールを示す断面図である。

〔図 2〕 図 1 に示す IC カードモジュール用リードフレーム形状の製造工程を示す断面図である。

〔図 3〕 従来の IC カードモジュールを示す平面図および断面図である。

〔図 4〕 図 3 のリードフレームを示す断面図である。

〔図 5〕 図 3 のリードフレームの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

5 半導体素子

13 リードフレーム

14 アイランド

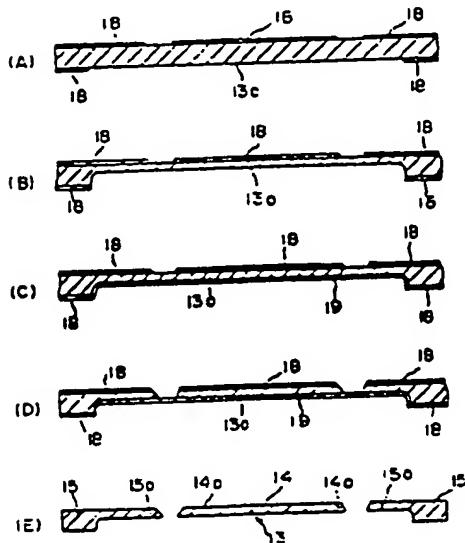
15 端子

16 外枠

17 モールド樹脂

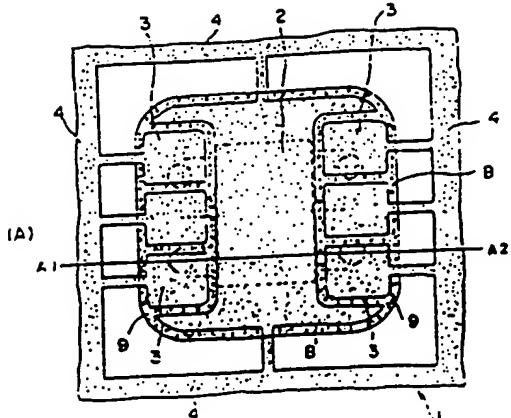
18, 19 レジスト

〔図 2〕

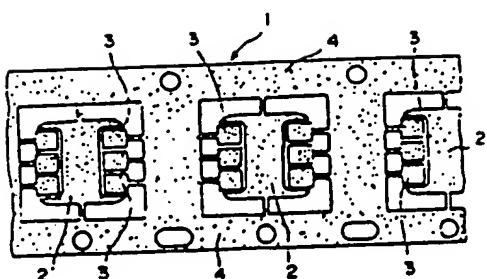


半導体リードフレームを有する IC カードモジュールの構造

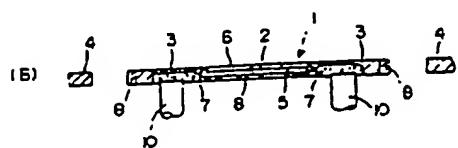
(図3)



(図4)

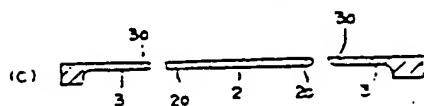
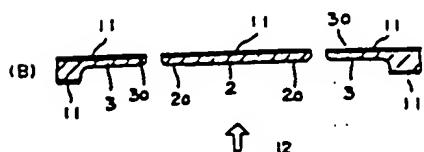
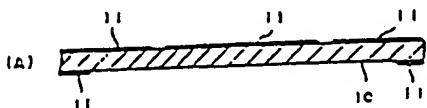


BIOV-1フレームの断面図



BIOV-1カーフラジーハルス区段構成図

(図5)



BIOV-1フレーム構成図

特許平6-92076

(5)

フロントページの続き

(5) Iol. Cl. 1
H 01 L 23/50

識別記号 厅内整理番号

H 9272-4M

F 1

技術表示箇所